

**华润微电子有限公司**  
**投资者关系活动记录表**

(2026年6月)

证券简称：华润微

证券代码：688396

<p>投资者关系活动类别</p>	<p><input type="checkbox"/>特定对象调研    <input type="checkbox"/>分析师会议</p> <p><input type="checkbox"/>媒体采访        <input type="checkbox"/>业绩说明会</p> <p><input type="checkbox"/>新闻发布会      <input checked="" type="checkbox"/>路演活动</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>现场参观</p> <p><input type="checkbox"/>其他（请文字说明其他活动内容）</p>
<p>参与单位名称</p>	<p><b>06月03日</b></p> <p>中信建投证券、东方证券、信达证券、华夏基金、建信基金、国寿养老、国信永丰证券、国泰基金、招商基金、太平基金、银华基金、交银施罗德基金、海富通基金、诚旻基金、盘京投资、泰康资产、国寿资产、中邮保险资产</p> <p><b>06月05日</b></p> <p>财通证券、东财证券、方正证券、国海证券、东方证券、长信基金、财通基金、宝盈基金、泰康资产、天弘基金、工银资产、华夏久盈基金、宏利基金、融通基金、兴全基金、招商基金</p> <p><b>06月09日</b></p> <p>巴克莱银行、国海证券、国信证券、申万宏源证券、东方证券、太保资管、太平资管、招银理财、金鹰基金、南方基金、鹏华基金、景顺基金、融通基金、平安基金、招商基金、大成基金、博时基金、华夏基金、诺安基金、信达澳亚基金、路博迈基金、国泰基金、中欧基金、风和资本、国投瑞银基金、尚信建投资本、宏颐投资</p>

	<p><b>06月15日</b></p> <p>中泰证券、方正证券、兴业证券、招商证券、开源证券、申港证券、美银证券、申万宏源证券、元潘投资、国泰基金、民生加银基金、西部利得基金、T Rowe Price、华安基金</p> <p><b>06月23日</b></p> <p>国海证券、开源证券、华泰证券、东方红、天风资管、河床资本、易方达基金、平安资产、Black Rock</p>
时间	06月03日、06月05日、06月09日、06月15日、06月23日
地点	无锡、上海、深圳、香港、北京
上市公司接待人员姓名	<p>吴国屹 华润微电子董事、财务总监兼董秘</p> <p>沈筛英 华润微电子董事会办公室主任</p>
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>问题一：请问公司产能利用率及订单能见度？</b></p> <p>答：公司当前产能与订单均处于饱满状态，待交订单规模持续攀升并创下新高。订单能见度最高达9个月，部分热门型号的待交订单周期已超过一年。</p> <p><b>问题二：请问公司在产能持续饱满的情况下还有哪些弹性空间？</b></p> <p>答：短期来看，公司将继续优化产品组合，重点推广高毛利及新品类产品，深化客户服务，确保供应保障与价格策略有效落地。中长期来看，公司将加速新品的产业化导入，持续推行柔性运营，全面提升产品综合竞争力。</p> <p><b>问题三：请问公司待交订单主要集中在哪些领域及产品？</b></p> <p>答：公司在重点平台、关键领域及重要大客户方面均实现了显著增长。得益于AI领域的高景气度与“算电协同”效应，应用于光</p>

储及新兴领域的 MOSFET、IGBT、第三代半导体及模块等产品，均呈现快速增长态势。

**问题四：请公司重点介绍在新兴领域的业务进展情况？**

答：公司在新兴领域已实现多点突破，产业化进程快速放量。在低空经济方面，应用场景正向农业植保、应急救援、物流配送等领域加速扩容，有效带动核心功率器件及 MCU 等产品的需求增长。在机器人领域，工业及商业服务场景日益丰富，已实现对重点客户的导入与上量。在服务器领域，伴随电源系统向 800V HVDC 高压直流架构演进，公司功率器件及模块产品持续上量，栅极驱动产品的开发也在快速推进。此外，在 SST（固态变压器）架构下，公司 SiC 产品已取得销售突破并获得多家客户备货订单。

**问题五：请问公司如何看待涨价的持续性？**

答：自调价通知发布以来，公司已与产品客户及制造服务客户进行专项沟通，调价策略推进有序。公司将充分利用当前产能紧张带来的有利时机，持续推进谈判工作，以核心产品为重心，逐步扩大涨价的覆盖范围。6 月以来，公司已启动第二轮价格谈判，此轮涨价会在第一轮基础上扩大产品和客户覆盖度。涨价的原因一方面来自上游原材料成本的压力，另一方面在手订单比较充足。

**问题六：请公司详细介绍面板级封装（PLP）工艺？**

答：PLP 封装的核心突破在于大尺寸面板的产业化应用。公司已成功解决 600mm×600mm 面板在翘曲、芯片偏移、图形对位及结构可靠性等方面的六大核心技术难题，封装良率稳定保持在 99.7%以上。该技术已广泛应用于 AI 服务器电源、手机及可穿戴设备的电源管理与逻辑电路、汽车微控制器等领域，同时正在与光模块领域头部客户合作开发新一代光模块电源驱动模块。公司具备从晶

	<p>圆制造到封装测试的一站式特色服务能力，有助于增强客户粘性并构筑更高的技术壁垒。</p> <p><b>问题七：公司在 SST 固态变压器领域的产品布局？</b></p> <p>答：公司在 SST 核心器件领域已形成完整布局。电压覆盖范围上，公司的 SiC MOS 单管与模块产品已覆盖 650V 至 2300V，更高电压等级的 3300V SiC MOS 亦在规划中。封装方面，已完成 Easy 系列、62mm 及 ED3 模块的布局。针对单相 500V 至 1.5kV 交流输入的应用场景，公司已开发 1200V 至 2300V 的 SiC 单管与模块，其中 1200V Easy 2B 4mR 模块已出样，AUX 电源所需的 1700V 及 2300V SiC 器件规格齐全，充分展示了公司在 SST 架构下布局的产品广度与技术深度。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2026 年 6 月